

# 中国互联网展会、2024年电子芯片展会、芯片展

产品名称	中国互联网展会、2024年电子芯片展会、芯片展
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

## 产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织架构

主办单位

中国通信工业协会

浙江省半导体行业协会

成都市集成电路行业协会

江苏省半导体行业协会

深圳市半导体行业协会

深圳市中新材会展有限公司

承办单位

深圳市中新材会展有限公司展会介绍

作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，其中69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、qiche、医疗等应用领域。2024第六届SEMI-e深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规

模超60,000m<sup>2</sup>，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。除此之外，展会同期将结合行业热点推出主题活动40+，邀请近百位行业院士、企业代表、业界大咖专题演讲行业前沿科技与思维，加速科研成果转换应用落地，全方位多角度推动中国半导体产业高质量发展。

第六届深圳国际半导体展将在深圳国际会展中心4号馆、6号馆和8号馆举行，3馆联动，10+细分展品类别，抢跑新兴产业机遇。本届展会将汇聚芯片设计、晶圆制造与封装、先进材料、Mini/Micro-LED、电源&储能技术、半导体专用设备&零部件、IC载板/陶瓷基板、电子元器件、第三代半导体、AI与算力、算法、存储、CPO共封装、汽车半导体/车规级先进封装技术、机器视觉与传感器、毫米波雷达、激光雷达/自动驾驶、微电子综合智造等领域，联动产业链上下游，实现一站式解决资源互通、信息交流、产品贸易的需求，成就不容错过的行业盛会。

以实际行动助力行业企业高质量发展，从商贸对接、新品发布、行业热点聚焦、创新技术交流等方面，集中展示智能信息化时代下半导体产业的新成果及趋势，全方位呈现当前半导体行业丰富多彩的面貌和蓬勃发展的生态。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、qiche半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级siC模块、电源管理芯片、qiche电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

### 开放共享 合作共赢

开放带来进步，合作共享共赢！第六届展会将积极扩大“国际朋友圈”，吸聚国际资源，重磅推出展区。组委会将积极联通国内外市场，深度挖掘市场优势与需求潜力，让到场观众得以近距离感受国际较为前沿的、潮流的核心技术和产品，助力中国和全球市场双向对接。

作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。随着国内各地相继出台了一系列半导体产业扶持政策，中国半导体产业有望在2024年迎来新的机遇和发展空间！深圳国际半导体组委会将继续立足市场，整合往届优质资源，为展商和观众双方合作共赢开辟新空间、为半导体产业链上中下游节点的企业搭建出共享、交流、共创的广阔平台，为行业打造了一场“双向奔赴”的采购盛宴。目前第六届深圳国际半导体的招商工作正在如火如荼地展开，各展区销售进度喜人。还有少量优质展位，预定从速！！

### 参展费用 ( Booth Rate )

标准展位：3m×3m=9m<sup>2</sup>；注：双开口加收10%双开口费，标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个

空地费用：( 36m<sup>2</sup>起租 )